

2008年3月25日

電子部品実装機（チップマウンタ）の新工場完成

- 埼玉県妻沼西部工業団地内に建設、生産能力を増強 -

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：大林 秀仁 / 以下、日立ハイテク）の100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ（群馬県邑楽郡大泉町、社長：生見 益三）は、2007年8月から埼玉県熊谷市にて建設を進めていた電子部品実装機（チップマウンタ）の新工場をこのたび完成させました。これに伴い、4月1日より本社、工場機能が新工場で本格稼働する予定です。

敷地面積は約32,500㎡で、土地の取得費用も含めた総投資額は約35億円です。新工場の完成により、電子部品実装機の実装能力増強と生産効率の向上を図ります。

携帯電話やデジタルカメラ、液晶・プラズマテレビなどのデジタル家電は、高機能・多機能化と同時に、小型・軽量・薄型化が要求されています。こういったなか、電子部品実装機には高精度化、生産性向上が求められています。また、国内での地上波デジタル放送の開始、北京オリンピックなどの影響により、日本国内だけでなくアジア、欧米でのデジタル家電製品の需要拡大が見込まれており、高速・高性能な電子部品実装機の需要が高まっています。

日立ハイテクインスツルメンツは、電子部品実装機の高効率生産、開発スピードの迅速化、品質・サービスの向上を図るため、今回埼玉県熊谷市に新工場を竣工し、2008年3月末に現在の本社・工場（群馬県邑楽郡大泉町）から移転します。新工場は、鉄骨2階建て、幅122m、奥行き70m、建屋高さ15mで、延べ床面積は17,500㎡となります。生産スペースを現在の約2倍に拡大することにより、部品受入から出荷までの一貫生産ラインを築くことで、生産効率の向上を図ります。

また、新工場内にグループ会社である株式会社日立ハイテクエンジニアリングサービスが担当しているチップマウンタのサービス機能も集約し、連携を図ることで、品質保証・サービス体制を強化します。同時に、設計から製造まで含めた生産方式の改革を実施し、年間1,200台の生産体制を構築する予定です。

日立ハイテクは、今回の新工場完成により生産能力増強と生産効率の向上を図り、同時に海外サービス拠点の拡充、サービス員の育成などにより電子部品実装機（チップマウンタ）事業の競争力を強化し、2010年度に世界シェア30%獲得を目指しています。

【新工場の概要】

- ・ 鉄骨2階建て
- ・ 所在地： 埼玉県熊谷市妻沼西一丁目6番地
TEL：048-506-6000(代表)
- ・ 敷地面積： 32,500㎡
- ・ 延べ床面積： 17,500㎡
- ・ 竣工日： 2008年2月29日
- ・ 稼働日： 2008年4月1日
- ・ 総投資額： 約35億円



日立ハイテクインスツルメンツ 新工場

お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクインスツルメンツ

管理本部 担当：川田

TEL：048-506-6000

報道機関お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクノロジーズ

社長室 広報・IRグループ 担当：塩澤

TEL：03-3504-5637